



<b>Title of Change:</b>	Transfer of Assembly and Test operation of former Fairchild SOT223 Eutectic Transistor to ON Semiconductor Seremban, Malaysia and change the wafer fab from Phenitec, Japan to ON Semiconductor ISMF, Malaysia.		
<b>Proposed First Ship date:</b>	16 Sep 2021 or earlier if approved by customer		
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Syahrul.SamsuddinA.Rahim@onsemi.com">Syahrul.SamsuddinA.Rahim@onsemi.com</a>		
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.		
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>		
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	Customers may receive the parts from Cebu once IPCN expired or earlier depending on customer approval. Parts from new assembly and test site can be identified through product marking which follow ON Semiconductor marking format.		
<b>Change Category:</b>	Test Change, Assembly Change, Wafer Fab Change		
<b>Change Sub-Category(s):</b>	Manufacturing Site Transfer		
<b>Sites Affected:</b>			
<b>ON Semiconductor Sites</b>		<b>External Foundry/Subcon Sites</b>	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia		Phenitec, Japan	
<b>Description and Purpose:</b>			
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>	
LeadFrame	Bare Cu with Ag Plating	Bare Cu w/ Ag Plating	
Die Attach	Eutectic	Eutectic	
Bond Wire	1.0 mil Au wire	1.0 mil Au wire	
Mold Compound	MC PA PLASKON AMC-2RC 14MMX 5.6G	MC GE-200F HWG	
Assembly Site	ON Cebu, Philippines	ON Seremban, Malaysia	
Other Changes	Phenitec, Japan	ON Semiconductor ISMF, Malaysia	
<b>Qualification Plan:</b>			
<b>QV DEVICE NAME: PZTA06</b>			
<b>RMS: S63340,S70992</b>			
<b>PACKAGE: SOT223</b>			
<b>Test</b>	<b>Specification</b>	<b>Condition</b>	<b>Interval</b>
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
H3TRB	JESD22 A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% rated or 100V max	1008 hrs
HAST-PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	

QV DEVICE NAME: PZTA56RMS: S63341,73399,67318PACKAGE: SOT223

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL-PC	MIL STD750, M 1037, AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min Ton=Toff is pkg dependent	15000 cyc
TC-PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST-PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

QV DEVICE NAME: PZTA64RMS: S63343,68056PACKAGE: SOT223

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC-PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST-PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 13 May 2021

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
PZTA06	PZTA06
PZTA56	PZTA56
PZTA64	PZTA64
PZTA14	PZTA06

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23914X

発行日: 31 Mar 2021

変更件名:	旧 Fairchild の SOT223 共晶トランジスタの組立および検査オペレーションをオン・セミコンダクター セレンバン (マレーシア) に移管、ならびにウェハー工場をフェニテック (日本) からオン・セミコンダクター ISMF (マレーシア) に変更
初回出荷予定日:	16 Sep 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:Syahrul.Samsuddin.A.Rahim@onsemi.com">Syahrul.Samsuddin.A.Rahim@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:PCN.Samples@onsemi.com">PCN.Samples@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	お客様は、セブからの製品を IPCN の期間満了後またはお客様の承認次第で早期に受け取ることができます。新しい組立および検査拠点からの製品は、オン・セミコンダクターのマーキングフォーマットに準拠した製品マーキングにより識別することができます。
変更カテゴリ:	検査の変更, 組立の変更, ウェハーファブの変更
変更サブカテゴリ:	製造拠点の移管

## 影響を受ける拠点:

外部製造工場 / 下請業者拠点:

ON Semiconductor Seremban, Malaysia

外部製造工場 / 下請業者拠点:

Phenitec, Japan

## 説明および目的:

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	銀めっきありのベア銅	銀めっきありのベア銅
ダイ接着剤	共晶	共晶
ボンドワイヤー	1.0 mil 金ワイヤー	1.0 mil 金ワイヤー
モールド・コンパウンド	MC PA PLASKON AMC-2RC 14MMX 5.6G	MC GE-200F HWG
組立拠点	オン セブ (フィリピン)	オン セレンバン (マレーシア)
その他の変更	フェニテック (日本)	オン・セミコンダクター ISMF (マレーシア)

## 認定計画:

デバイス名 : PZTA06

RMS : S63340,S70992

パッケージ : SOT223

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
H3TRB	JESD22 A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% rated or 100V max	1008 hrs
HAST-PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23914X

発行日: 31 Mar 2021

デバイス名 : PZTA56

RMS : S63341,73399,67318

パッケージ : SOT223

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
IOL-PC	MIL STD750, M 1037, AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min Ton=Toff is pkg dependent	15000 cyc
TC-PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST-PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

デバイス名 : PZTA64

RMS : S63343,68056

パッケージ : SOT223

テスト	規格	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC-PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST-PC	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

認定完了予定日 : 13 May 2021

## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
PZTA06	PZTA06
PZTA56	PZTA56
PZTA64	PZTA64
PZTA14	PZTA06